

化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム 2019

主催：化学工学会 材料・界面部会

協賛：（一社）日本接着学会、（公社）高分子学会、（公社）日本化学会、（一社）日本レオロジー学会、
（一社）日本 MRS、（公社）石油学会

日時：2019年1月10日(木) 12時45分～18時30分（受付 12時00分開始）

会場：東京大学 武田先端知ビル 武田ホール (http://www.denki.or.jp/committee/nuc/takeda_map.pdf)

参加費：シンポジウム：一般、部会員ともに 5000 円（学生無料）、懇親会：一般、部会員ともに 3000 円

材料・界面部会では、各種材料プロセスを横断するような共通課題（基盤技術）について議論する場を継続的に提供しています。その議論の中から、各研究・技術における共通性を見だし、学会と産業界との連携を図り、基盤技術の体系化を図ることを目指しています。今年度は、接着・粘着技術から、構造接着、異種材料接着、接着プロセス技術、接着評価技術までを一連のトピックとして取り上げます。接着設計と管理に関する基礎現象の理解から接着技術の応用展開まで俯瞰的に捉え、広い分野に共通する基盤技術について議論をします。奮ってお申し込みいただきますようお願いを申し上げます。

プログラム

開会の挨拶(12:45～12:50) 材料・界面部会長 同志社大学 塩井 章久 氏

①12:50～13:30 原賀康介 氏（(株)原賀接着技術コンサルタント）

「接着技術の現状・課題と取り組み」

②13:30～14:10 若林一民 氏（エーピーエスリサーチ）

「金属・プラスチックの異材接合：接着剤の正しい選び方と使いこなし」

③14:10～14:50 鈴木靖昭 氏（鈴木接着技術研究所）

「金属の接着：ステンレス鋼の接着と評価」

休憩

④15:00～15:40 上坂一郎 氏（日本プラズマトリート(株)）

「大気圧プラズマを用いた接着」

⑤15:40～16:20 市川 功 氏（リンテック(株)）

「半導体用材料の要求仕様と精密解析による材料設計」

⑥16:20～17:00 田口哲志 氏（物質・材料研究機構・機能性材料拠点）

「材料と生体との界面接着性制御による医療用材料の開発」

休憩

⑦17:10～17:50 秋山陽久 氏（産業技術総合研究所・機能化学研究部門）

「可逆接着剤の開発と接着界面に関する研究」

⑧17:50～18:30 奥村治樹 氏（ジャパン・リサーチ・ラボ）

「界面分析・評価：接着における制御・解析のための分析技術」

懇親会(18:45～20:15) 場所：東京大学 武田先端知ビル 武田ホール ホワイエ

(http://www.denki.or.jp/committee/nuc/takeda_map.pdf)

申込み方法・問い合わせ先

E-mail にて、氏名、所属、連絡先 (Tel, E-mail) および懇親会の参加の有無を明記の上、下記宛にお申込み下さい。下記の URL にアクセスすると簡単に申し込みが可能です。

<https://www1.doshisha.ac.jp/~molcheng/symposium.html>



化学工学会 材料・界面部会事務局 山本大吾(同志社大学理工学部化学システム創成工学科 内)

E-mail: regist-sympo@mail.doshisha.ac.jp Tel: 0774-65-6564

参加費ならびに懇親会費は当日、会場受付にてお支払い願います。

申し込み〆切 12/17(月) 17:00

以上